

Title (en)

Method of activating substrate surfaces for electroless metal plating.

Title (de)

Verfahren zur Aktivierung von Substratoberflächen für die stromlose Metallisierung.

Title (fr)

Procédé pour l'activation de surfaces de substrats pour la métallisation sans courant électrique.

Publication

**EP 0081129 A1 19830615 (DE)**

Application

**EP 82110736 A 19821120**

Priority

DE 3148280 A 19811205

Abstract (en)

[origin: US4764401A] A mild and simple process of activating substrate surfaces for the purpose of currentless metallization comprises using organometallic compounds of elements of the groups 1B and 8 of the Periodic System of Elements whose organic moiety has at least one functional group over and above the groups required for binding the metal are used for activation.

Abstract (de)

Eine schonende und verfahrenstechnisch einfache Methode zur Aktivierung von Substratoberflächen zum Zwecke der stromlosen Metallisierung besteht darin, daß man zur Aktivierung metallorganische Verbindungen von Elementen der 1. und 8. Nebengruppe des Periodensystems der Elemente verwendet, deren organischer Teil über die zur Metallbindung erforderlichen Gruppen hinaus wenigstens eine weitere funktionelle Gruppe aufweist.

IPC 1-7

**C23C 3/00**; **C23C 17/00**

IPC 8 full level

**C23C 18/30** (2006.01); **C23C 18/18** (2006.01); **C23C 18/28** (2006.01); **H05K 3/18** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**C23C 18/28** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- DE 2527096 B2 19780713
- DE 1521445 A1 19701008 - PHOTOCIRCUITS CORP
- CH 592160 A5 19771014 - SIEMENS AG
- CH 564093 A5 19750715 - KOLLMORGEN PHOTOCIRCUITS

Cited by

DE3938710A1; EP0259754A3; CN108624907A; EP0564673A1; US5378268A; EP0195332A3; US4728560A; EP0146724A1; US4554183A; US5487964A; EP0146723A1; US4568571A; DE19941043A1; DE19941043B4; EP0166327A3; EP0153683A3; EP0166360B1; EP0082438B1; WO2019063859A1; WO2019063773A1; US10501852B2; EP3848483A2; US11898250B2

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB IT SE

DOCDB simple family (publication)

**EP 0081129 A1 19830615**; **EP 0081129 B1 19870114**; DE 3148280 A1 19830609; DE 3275105 D1 19870219; JP S58104170 A 19830621; JP S6354792 B2 19881031; US 4764401 A 19880816

DOCDB simple family (application)

**EP 82110736 A 19821120**; DE 3148280 A 19811205; DE 3275105 T 19821120; JP 21282082 A 19821206; US 770687 A 19870128